

## A la une

- Actualités
- Dossiers
- Paroles d'entrepreneurs
  - ▶ Sur LCI
  - ▶ Dans "01 Informatique"
  - ▶ Sur France Info
  - ▶ Autres témoignages
  - ▶ Dans "L'Entreprise"
- Agenda
- Vidéothèque
- OSEO news

## 3D Plus



Lundi 04 Août 2008

### Spécialiste mondial dans la miniaturisation des composants électroniques



Créée en 1996 à la suite d'une externalisation de Thomson-CSF, la société 3D Plus est spécialisée dans la fabrication de composants microélectroniques.

#### Une technologie de pointe

Elle les empile en 3D pour en améliorer les performances et réduire le volume de ces modules dans un rapport compris entre 10 et 30. Elle dispose de près de 25 brevets sur sa technique d'empilage de substrats.

3D Plus vise les marchés des microcomposants indispensables dans les secteurs du spatial, du médical, de la défense et de l'industrie. Elle a déjà été qualifiée par les agences spatiales (CNES, ESA, NASA). Elle a, entre autres, participé à la mission européenne Rosetta ainsi qu'à la future mission sur Mars qui sera effectuée par la NASA, avec un petit robot pour lequel 3D Plus a fourni la caméra intégrée.

#### 90% du CA à l'export

Aujourd'hui, 3D Plus vend sa technologie de pointe dans le monde entier où elle réalise les 90% de son chiffre d'affaires. Elle exporte ainsi en Europe, aux Etats-Unis, et même en Chine et Japon, pays connus pour leurs expertises en miniaturisation.

#### Prix Lynx 2007 d'EUREKA

L'entreprise a reçu le [prix Lynx 2007 d'EUREKA](#), décernée à une entreprise Européenne innovante. La technologie concernée permettra de réduire encore d'un facteur 20 à 50 le volume des modules électroniques. La fabrication en grand volume pourrait être faite par une société de semi-conducteurs comme Philips, devenu depuis NXP avec laquelle 3D Plus a signé un accord.

Elle travaille également sur des dispositifs utilisant sa technologie pour des applications médicales et aussi industrielles, l'intégration de plusieurs puces dans une carte SIM par exemple. Elle affiche une croissance moyenne de 20% par an.

#### Soutien OSEO

OSEO Ile-de-France a accompagné la société 3D Plus, dès sa création, en soutien à l'innovation (études de faisabilité et aides à l'innovation). L'entreprise a été labellisée "entreprise innovante" dans le cadre des FCPI.

*Parcours de Christian Val* : passionné d'innovations technologiques. Docteur - ingénieur en physique, diplômé d'une IAE (gestion des entreprises), il a déposé plus de 70 brevets et écrit plus d'une centaines d'articles techniques dans des publications internationales. Après avoir passé 27 ans chez Thomson-CS, il crée 3D Plus en 1996.

## 3D Plus

**Création** : 06/10/1995  
**Forme juridique** : SA  
**Chiffre d'affaires** : 8,00 M€ (exercice 2007)  
**Chiffre d'affaires à l'export** : (= 90 %)  
**Effectif** : 56 personnes

### Coordonnées

641, rue Hélène Boucher  
78532 Buc cedex  
Tél. : 01 30 83 26 51  
Télécopie : 01 39 56 25 89  
Courriel : [val@3d-plus.com](mailto:val@3d-plus.com)  
Site : [www.3d-plus.com](http://www.3d-plus.com)  
Région : [Ile-de-France](#)

### Contact(s)

Christian Val,  
PDG

## Secteurs

**Secteur d'application** : MICROELECTRONIQUE (ELEC)

**Secteur d'innovation** : ELECTRONIQUE (TIC)

## Horaires de diffusion sur LCI

*Du lundi au vendredi* :  
6h15 - 9h55 - 13h40 - 16h10 - 21h55.

*Les samedi et dimanche* :  
10h50, 16h10, 21h40



## Nos flux RSS

Retrouvez les derniers reportages OSEO/LCI

